

TCL科技携手协鑫集团共投120亿元建设光伏级和电子级硅料项目

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聚焦于半导体显示、半导体光伏及半导体材料的核心科技产业发展，因应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，进一步推动企业绿色高质量发展，实现公司半导体光伏及半导体材料业务领先的战略目标，公司及公司控股子公司天津中环半导体股份有限公司于近日与协鑫集团有限公司及协鑫科技控股有限公司签署了《合作框架协议书》。

主要内容

协议签署各方：

甲方：TCL科技集团股份有限公司

乙方：天津中环半导体股份有限公司

丙方：协鑫科技控股有限公司

丁方：协鑫集团有限公司

1、合作目的

2022年4月7日甲方、乙方分别与内蒙古自治区人民政府和呼和浩特市人民政府签署了内蒙古中环产业城项目群有关合作协议，拟在公司原有产业基地的基础上进一步打造形成内蒙古中环产业城，建成具备国际竞争力、国内最重要的单晶硅材料制造产业基地。

各方本着平等互利、资源共享、优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，就关于在内蒙古呼和浩特市合作投资新建光伏级和电子级硅料项目，达成本合作框架协议书，并为今后进一步深入合作建立坚实基础达成共识。合作期间各方将充分发挥各自的优势和资源，坚持互惠共赢、同等优先的原则，不断拓展合作领域，提高合作水平，构筑良性互动、共同发展的新格局。

2、项目主要合作内容及原则

(1) 各方拟就约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目（下称“光伏多晶硅项目”）、约1万吨电子级多晶硅项目（下称“电子级多晶硅项目”，与光伏多晶硅项目合称“合作项目”）进行战略合作。

(2) 光伏多晶硅项目：由甲方、丙方或其各自控股子公司在内蒙古呼和浩特投资设立一家合资公司实施，总投资预计为90亿元，甲方、丙方或其各自控股子公司在合资公司中的股权比例拟定为40%、60%。

(3) 电子级多晶硅项目：由甲方、丙方关联方在内蒙古呼和浩特投资设立一家合资公司实施，总投资预计为30亿元，甲方、丙方关联方在合资公司中的股权比例拟定为40%、60%。

(4) 乙方承担日常联络工作，协调上述合作项目落户中环产业城，并依照与当地政府的合作协议约定享受项目优惠政策。

3、其他事项

本框架协议合作内容不对任何一方构成具有法律约束力的义务，且相关协议内容的实施以各方分别取得各自适当机构之批准为前提。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/181102.html>